



行业动态  
Industry News



- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意

### 联发科减少两晶圆订单或波及整个供应链

2010-02-26 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

2月25日消息,据台湾媒体报道,手机芯片大厂联发科为控制库存保持在正常水位,拟减少在晶圆代工厂台积电、联电的投片量,幅度约10%到20%,此举或引发业界对晶圆代工业出现“重复下单(double booking)”的担忧,为第二季订单蒙上阴霾。

针对传出联发科拟减码投产事件,联发科主管昨天表示,联发科有多家晶圆代工合作伙伴,调整对个别厂商下单数量是常有的事,并不表示看淡市场需求,且联发科上季库存水位虽上升,但仍维持在正常水位。

联发科是国内最大、全球第二大手机芯片厂商,也是台积电、联电主要客户。

有关分析人士表示,由于部分IC设计公司出现库存升高迹象,如果联发科决定下修对台积电、联电投片,可能会引发其他IC设计公司或整合元件制造厂跟进减少投片量。

一旦整个供应链开始反映联发科下调动作,封测厂商日月光、硅品、京元电等产能利用率将同受冲击;联发科概念股包括茂达、奕力、旭曜、硅创等也将受波及。

(来源:腾讯科技 2010年2月25日)